

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	山西证券、方正证券、华金证券
时间	2024年3月20日-2024年3月21日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	常务副总经理、董事会秘书：陈小华 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	<b>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</b> <b>问题一：公司是否有产品可以用于HBM封装工艺？</b> 回答：公司现有量产产品“先进封装负胶”、“电镀铜基液”、“铜钛蚀刻液”以及客户认证中的“电镀锡银添加剂”等产品可以用于HBM封装。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无

日期	2024年3月21日
----	------------